

後工程向け薬液強化

新ブランドで性能訴求

奥野製薬工業(株)(大阪市中央区)は、TSVやFOPLP/WLPなど半導体

後工程向けの薬品を強化している。新ブランド「トライザ」を4月に立ち上げて

おり、後工程のウエハー処理プロセスにおける認知度向上と採用拡大を目指す。

同社はプリント基板や半導体パッケージ基板向けに「トップ」のブランド名で各種めっき薬品を展開している。TSVなどの後工

程プロセス向けにも約15年前から薬品を開発している。新ブランド「トライザ」を4月に立ち上げて

名前が低かった。近年、FOPLP/WLPなどの先端後工程技術が注目され、今後さらなる市場拡大が見込まれることを受けて、同分野における事業拡大を目指すして新ブランドを立ち上げた。

トライザは「トップ」とラテン語で稲穂を意味する「Oryza」を組み合わせた造語で、産業のコメといわれる半導体を同社のコメにしようという意志が込められている。発足時には全社に対して役員が告知す

るなど、会社として取り組む姿勢を鮮明にした。立ち上げと同時に、半導体分野を専門とする研究組織も発足した。

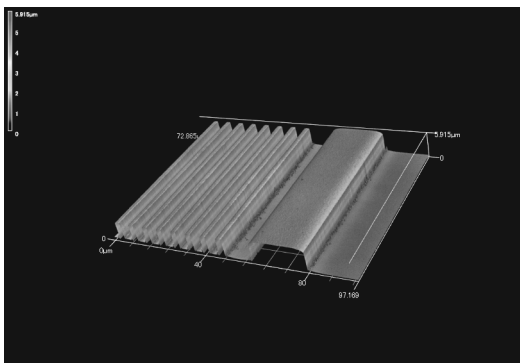
トライザシリーズとしてシリコンインターポザー向けの「LCN SV」、FOPLP/WLP向けの「LCN SP」、高放熱

また、JPCA Show 2023ではビルドアップ向けの「トップルチナHS5」、MSAPに最適な「トップルチナGAP」およびLCN FRVを用いたソリューションを紹介

し、JPCAアワードを受賞した。ELPプロセスは、パワーデバイスの接合用に伸びている。顧客ニーズに対応し、12インチウエハーに対応できる全自動無電解めっき装置を開発した。ELPプロセス以外のシリーズについても、装置の製品化を検討していく。

現在、放出工場(大阪市鶴見区)に新棟を建設して

おり、25年の完成を予定している。基板用薬液の生産能力を増強することも、クリーンルームを設置して半導体後工程用製品の本格的な生産に対応する。同社は25年度に売上高400億円を目指しており、トライザはもとより基板向けなどエレクトロニクス関連を大きな柱として育成し目標の達成を目指す。



トライザLCN FRVによる処理

るなど、会社として取り組む姿勢を鮮明にした。立ち上げと同時に、半導体分野を専門とする研究組織も発足した。

トライザは「トップ」とラテン語で稲穂を意味する「Oryza」を組み合わせた造語で、産業のコメといわれる半導体を同社のコメにしようという意志が込められている。発足時には全社に対して役員が告知す

